

第12回金型関連技術発表講演会開催のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は日本金型工業会の活動に格別のご理解ご協力賜り厚く御礼申し上げます。

さて、西部支部主催第12回金型関連技術発表講演会を3月6日（水）に開催致します。万障お繰り合わせの上ご出席のほどお願い申し上げます。なお準備の都合がございますので、別紙の参加申込書に必要事項をご記入の上、2月28日（水）までに、事務局にメールr.tsuji@jdmia.or.jp か FAX06-6479-1479でご返信のほどお願い申し上げます。

敬具

記

日 時 令和6年3月6日（水） 13時30分～17時45分

18時10分～懇親会（予定）

内 容 1. 基調講演 13時30分～15時

テーマ：今求められている金型加工技術

講師：中部大学 生産技術開発センター 鈴木浩文 様

<https://www.chubu.ac.jp/>

2. 技術発表講演会 15時10分～17時45分 予定

6社による金型関連技術発表

場 所 大阪科学技術センタービル 8階小ホール

大阪府大阪市西区靱本町1-8-4 【別紙案内図参照】 ※懇親会場（本町駅付近を予定）

参加費 無料

懇親会 5,000円（当日現金にて申し受けさせていただきます）

※申し込み後、懇親会をキャンセルされます場合は3月4日までにご連絡下さい。

（当日キャンセルの場合は懇親会費を後日請求させていただきます）

申込み方法 別紙参加申込書を2月28日までにメールかFAXでお送り下さい

メール r.tsuji@jdmia.or.jp

FAX 06-6479-1479

問い合わせ先・申込先 一般社団法人日本金型工業会西部支部 辻

〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-8-4 大阪科学技術センタービル305

電話 06-6479-1477 FAX 06-6479-1479

メール r.tsuji@jdmia.or.jp

以上

■ 基調講演（講演概要）

テーマ：今求められている金型加工技術

講師：中部大学 生産技術開発センター 鈴木浩文 様

★講演概要★

1980年代に米国の超精密加工技術が日本に導入され、独自の加工装置、工具、プロセスが開発されながら、アナログからデジタルへの移転に伴って記録デバイス、映像デバイス、通信デバイスなどの開発・生産が急速に展開された。

しかし円高に伴う生産拠点の海外移転、空洞化が進み、先端デバイスの生産がアジアに取って代わられるようになり、急速に低迷し続けた。その状況においても一部の医療デバイス、車載機器などは国内で展開された。

今後、中国経済の急激な減速、国内のデフレの脱却（インフレの加速）、円安が予想され、AI、自動化の活用により人口減少を克服し、より付加価値の高い光学素子・金型の開発が必要である。本講演では、これまでの光学部品加工装置と加工技術の発展の経緯を振り返り、最新動向と今後開発が要望される技術について考察する。

■ 技術発表講演会 内容 I

【プログラム①】

テーマ：今後も注目され続ける組立成形

会社名：(株)坂本金型工作所

発表者：大平 泰輝 氏

発表内容

プラスチック射出成形技術の「中空体ができる組立成形技術」（DSI：ダイ・スライド・インジェクション）の基本特許が切れて数年が経ちました。

昨今はギガキャストなど複数のパーツのアセンブリ化によって得られる組立工数の削減は、車業界に限らず、今後も多方面において増え続ける傾向にある。様々なコスト削減の可能性を秘めた組立成形（DSI技術）を今一度ご紹介します。

【プログラム②】

テーマ：樹脂およびダイカストのハイサイクル成形に貢献するベリリウム銅

会社名：NGKファインモールド(株)

発表者：高原 拡生 氏

発表内容

鋼材の最大7倍の熱伝導性をもち、高硬度なベリリウム銅の金型および部品は、冷却時間の短縮化による生産性向上と、均一冷却による成形品の変形抑制や品質安定化を実現するなど、ハイサイクル成形の分野で好評を得ている。

一方、自動車軽量化の一環で、ガラス繊維が配合されているエンジニアプラスチック素材の活用が拡大し、金型の摩耗を加速させる要因となっている。同様にダイカスト製造においても、より過酷な条件にシフトしており、溶損やクラックの発生が懸念される。本講演において、それに対する長寿命化〔耐久性向上〕の取り組み含め、ベリリウム銅の特徴を紹介する。

【プログラム③】

テーマ：部品検査における2D図面データ（DXF）から、寸法および公差情報を3Dモデル内に
植え付ける技術の紹介

会社名：(株)アルモニコス

発表者：山根 雅則 氏

発表内容

本稿では業界全般で普及している「非接触測定機を利用した検査業務」に焦点をあて、実運用されている計測点群（実物）と「3Dモデルデータ+2D図面データ(DXF)」において、「2D図面データ」の寸法及び公差情報を効率よく「3Dモデルデータ」内に植え付け、非接触測定機を利用した検査業務に適用できる技術について紹介する。

【プログラム④】

テーマ：金型見積り支援ツールのご紹介

会社名：(株)CAEソリューションズ

発表者：大桑 一 氏

発表内容

樹脂流動解析を活用した見積り支援ツールをご紹介します。

サイクルタイム、充填可能性、冷却品質、反りなどの成形品品質を予測しつつ、成形品単価見積りを行えます。また、金型の見積りも同時に行えます。今回は、多数個取り金型についての事例をご紹介します。

【プログラム⑤】

テーマ：オートデスク FUSION360 にみる

サブスクリプション式CAD/CAMの導入稼働実績報告

会社名：愛和システムソリューションズ(株)

発表者：和栗 正昭 氏

発表内容

100年に1度と言われる「ものづくり変革期」において、CAD/CAMシステムもその例外ではありません。AI, IoT, DXとデータを軸とする金型製造の在り方が今後益々問われていくことになろうかと思われまます。世界No.1 CAD/CAMメーカーである、米国オートデスク社の世界戦略商品「FUSION360」がリリースされてからおよそ5年。FUSION360は同時5軸制御まで対応できるCAM機能を搭載しながら、安価なサブスクリプション（定額課金方式）が話題となっていますが、その実力と実績が気になるかと思ひます。

当社は、特にCAMに特化した稼働支援を行っており、今までの導入稼働実績の事例報告をさせていただきます。合わせて、オートデスク社の日本法人FUSION360担当責任者もお呼びして、FUSION360の開発ロードマップと日本市場における今後の展開についてご案内いただきます。

【プログラム⑥】

テーマ：半導体封止金型向け最新放電加工技術の紹介

会社名：三菱商事テクノス(株)

発表者：田中 秀彦 氏


三菱電機(株)

発表者：彦坂 博紀 氏

発表内容

今後も堅調な成長が見込まれる半導体産業において、半導体製造の後工程で必要となる半導体封止金型の生産性改善や品質向上が求められている。

本講演では半導体封止金型向けに開発した放電加工機の最新技術の紹介と半導体封止金型の加工の事例を紹介する。


第12回金型関連技術発表講演会（3月6日）
参加申込書
（FAX 06-6479-1479）

会社名		
部署名／お役職		() 講演会・発表会
お名前		() 懇親会 5,000円
部署名／お役職		() 講演会・発表会
お名前		() 懇親会 5,000円
電話番号／FAX	電話：	FAX：
メールアドレス		

下記に○を付けて下さい。

(一社) 日本金型工業会 (会員 会員外)



大阪科学技術センタービル
 (OSTEC)
 〒550-0004
 大阪市西区靱本町1-8-4

地下鉄四つ橋線「本町駅」
 28番出口より北へ徒歩3分
 地下鉄御堂筋線「本町駅」
 2番出口より西へ徒歩7分

「大阪科学技術館」の看板が目印です。そちらにお入り下さい。駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用下さいます様お願い申し上げます。